

# 四川省电子学会SMT/MPT专委会

## CEIA 中国电子智能制造高峰论坛·成都站

### 邀请函

由 CEIA 主办，四川省电子学会 SMT/MPT 专委会协办的电子智造高峰论坛，将于 2023 年 5 月 19 日在**成都新希望高新皇冠假日酒店**隆重举行，**20 场精彩主题演讲**，**44 家知名品牌展示**，融合系统集成产业链，从微组装到先进封装。

现场分享内容涵盖 SiP 系统级封装、SiP 封装清洗工艺、芯片烧录质量、激光标记、喷码工艺、贴片工艺、无空洞焊接、真空共晶炉、3D 视觉检测、AI 技术应用、移动机器人、智能化工厂、数字化工厂、一体化建设等热门智造话题。

活动邀请到 **CEIA 专家智囊、14 所工艺工程经理、四川省电子学会 SMT/MPT 专委会专家委员熊猫电子制程总监、29 所微组装专家、工信部电子五所元器件与材料研究院高级副院长**等行业大咖实力分享 BGA 焊接断裂的原因及判断方法、高可靠产品清洗工艺及设备、底部焊盘元件的焊接品质优化解决方案、微组装材料国产化验证和规模化应用研究、元器件国产化应用遇到的挑战与系统解决方案...



汇聚智造创新，洞察前沿新知

参会◎重好礼，“码”上报名

# 中国电子智能制造高峰论坛·成都站

2023年5月19日

## 活动议程

时间	演讲	时间	演讲
<b>宴会 A 厅—精准智造专场</b>		<b>宴会 B 厅—高可靠性专场</b>	
08:00-08:50	听众准时签到、领取会议资料		
08:50-09:00	领导开幕致辞、参会企业介绍	08:50-09:00	领导开幕致辞、参会企业介绍
09:00-09:30	<b>芯片烧录的技术挑战与解决方案</b> ACROVIEW 昂科技术	09:00-09:30	<b>无空洞焊接解决方案</b> REHM 锐德
09:30-10:00	<b>3D 视觉检测技术与智能化工厂配套方案</b> MAGICRAY 明锐理想	09:30-10:00	<b>MiR AMR 在电子半导体行业的多场景应用</b> MIR 自主移动机器人
10:00-10:30	<b>Sip 封装清洗工艺及废水处理方案</b> ZESTRON 洁创贸易	10:00-10:30	<b>AI 在视觉检测领域的价值与落地挑战</b> MAKER-RAY 镭晨科技
10:30-10:55	茶歇及参观展示/宣传片播放 <b>返回至会场/互动游戏赢好礼</b>		
10:55-11:25	<b>AI 智能检测视觉的优势</b> TRUTECK 图锐智能	11:00-11:30	<b>激光精微标记及其应用</b> NOC 恩欧西
11:25-11:55	<b>激光打标、喷码工艺及应用探讨</b> R-TEK 瑞天智能	11:30-12:00	<b>数字化工厂建设</b> YESSYS 研成工业
12:00-13:00	午餐及参观展示/宣传片播放/好礼抽奖 <b>返回至会场/互动游戏赢好礼</b>		
13:00-13:35	<b>电子行业企业战略软实力信息指挥系统一体化建设之术</b> 宋官琼 北京华微世纪科技有限公司 总经理	13:00-13:35	<b>SiP 系统级封装工艺及制造技术解决方案</b> 孙睿 上达电子遂宁有限公司 CTO 兼 CMO 原华为终端工程工艺技术专家
13:35-14:00	<b>台达智能制造，赋能行业伙伴</b> DELTA 台达集团	13:35-14:00	<b>国之重器、突破垄断、引领未来，易通贴片机</b> E-Line 易联自动化
14:00-14:25	<b>BGA 焊接断裂的原因及判断方法(EDS,切片...)</b> 曹用信 CEIA 专家智囊资深技术顾问	14:00-14:25	<b>真空共晶炉在微组装中的应用</b> TORCH 同志科技
14:25-14:50	茶歇及参观展示/宣传片播放 <b>返回至会场/互动游戏赢好礼</b>		
14:50-15:20	<b>高可靠产品清洗工艺及设备</b>	吴民 南京电子技术研究所(14所) 工艺工程经理	
15:20-15:50	<b>底部焊盘元件的焊接品质优化解决方案</b>	马龙 成都熊猫电子科技有限公司 制程总监	
15:50-16:20	<b>微组装材料国产化验证和规模化应用研究</b>	罗建强 中国电子科技集团公司第二十九研究所 高级工程师	
16:20-16:50	<b>元器件国产化应用遇到的挑战与系统解决方案</b> 元器件与材料研究院 高级副院长	罗道军 工信部电子五所(中国赛宝实验室)	
16:50	<b>会后活动 多重好礼 多重精彩 人人有礼</b>		